

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2025 年 5 月 8 日）

编号：LT2025-006

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华泰柏瑞、融通基金、东吴证券、山西证券、泰信基金
时间	2025 年 5 月 8 日
地点	公司会议室、线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵彧女士
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题及回复 问题 1：请介绍一下公司 2025 年 1 季度研发投入的情况？ 回复：公司 2025 年 1 季度研发投入 2,759.14 万元，占营业收入的比重为 25.31%，同比增长 23.24%。主要系公司为加快新产品研发进度，持续加强研发人才引进力度，增加研发人员薪酬所致。 问题 2：公司如何看待 AR/VR 市场？ 回复：公司的桥接芯片在 AR/VR 分离式头显领域应用广泛，已拓展了 Xreal、Rokid、TCL 雷鸟在内的多家国内领先的 AR/VR 硬件厂商。随着技术创新与行业应用的持续推动下，相信未来几年全球 AR/VR 市场可能会呈现强劲增长态势，公司持续看好该领域前景，将其中的视频技术作为公司未来重要的业务方向之一，持续加大研发投入、开发新产品，进一步提升产品性能及降低功耗，以适配更多的国际知名客户的分离式及一体式头显产品。 问题 3：请介绍一下公司拟建设的科创（研发）基地项目的基本情况？ 回复：为更好的实现公司战略规划，改善公司整体的科研和运营环境，公司

	计划在安徽省合肥市经济技术开发区投资建设该项目，项目规划用地面积约43.72亩，拟建设研发楼、产品测试中心、办公楼及其配套设施，购置研发设备、测试设备、辅助设备等，项目预计总投资约人民币3.43亿元。投入资金的来源为公司自有或自筹资金。研发基地建成并投入使用后，将大幅改善公司整体的科研条件和运营环境，进一步提升公司研发能力和综合竞争实力。
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2025年5月9日